

Высокочистый Кассетный Держатель Для Травления Пластин Из Птфэ Для Очистки И Стойкости К Кислотам Полупроводниковых Кремниевых Пластин

Артикул: PL-CP09



введение

Кассеты для пластин из премиального ПТФЭ, разработанные для травления и очистки в полупроводниковой промышленности. Превосходная стойкость к плавиковой кислоте и высокочистая конструкция обеспечивают безопасное обращение с кремниевыми пластинами в критически важных мокрых процессах. Идеально подходят для подложек от 2 до 12 дюймов в условиях чистых помещений.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Травление HF	Погружение кремниевых пластин в плавиковую кислоту для удаления естественных оксидов или жертвенных слоев.	Полная стойкость к HF гарантирует нулевую деградацию материала или загрязнение.
Очистка RCA	Стандартизированная многоступенчатая очистка (SC-1 и SC-2) с использованием перекиси водорода и гидроксида аммония.	Высокочистый ПТФЭ предотвращает повторное осаждение ионов металлов на поверхности пластин.
Производство солнечных элементов	Обработка кремниевых пластин во время этапов текстурирования и очистки после диффузии фосфора.	Прочная конструкция поддерживает высокую производительность в промышленном производстве солнечных элементов.
Сложные полупроводники	Обработка пластин из GaAs, GaN и SiC для силовой электроники и РЧ-применений.	Щадящая конструкция пазов предотвращает повреждение хрупких высокоценных подложек.
Фотолитография	Поддержка пластин во время процессов проявления и удаления фоторезиста с использованием органических растворителей.	Конструкция, устойчивая к растворителям, предотвращает набухание или размягчение держателя.
Ополаскивание после CMP	Высокочистое ополаскивание пластин после химико-механической полировки для удаления частиц суспензии.	Гладкие поверхности способствуют полному удалению абразивных частиц во время ополаскивания.
Производство МЭМС	Критически важная обработка микроэлектромеханических систем во время подготовки к глубокому реактивно-ионному травлению (DRIE).	Точное расположение пазов поддерживает выравнивание для сложных микроструктурированных пластин.
Ультразвуковая очистка	Использование в ультразвуковых или мегазвуковых ваннах для удаления мелких частиц с подложек.	Материал эффективно гасит вибрации, одновременно сопротивляясь кавитационным повреждениям.

Параметр	Детали спецификации для PL-CP09
Серия моделей	PL-CP09 (Стандартные и пользовательские кассеты)
Материал	Высокочистый первичный ПТФЭ (Политетрафторэтилен)

Применение	Описание	Ключевое преимущество	
Параметр	Детали спецификации для PL-CP09		
Размер пластины	Тип держателя	Стандартное количество пазов	Доступность кастомизации
Совместимость с размерами пластин	1", 2", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 6", 8", 12"		
Стили конфигурации	Держатель для одной пластины, Многоместная кассета, Пользовательские компоновки		
Вместимость пазов (одиночная)	1-5 пластин (доступно для размеров до 12")		
Вместимость пазов (многоместная)	Стандартная 25-пазовая или пользовательские конфигурации высокой плотности		
Рабочая температура	-200°C до +260°C (-328°F до +500°F)		
Химическая стойкость	Все распространенные кислоты, щелочи и растворители (за исключением расплавленных щелочных металлов)		
Производственный процесс	Полная ЧПУ-обработка (Нулевые загрязнения от литья под давлением)		
Варианты ручек	Одиночная вертикальная ручка, двойные боковые ручки или пользовательские интерфейсы для роботов		
Чистота поверхности	Ra < 0.8 мкм (Высокополированная отделка доступна по запросу)		

Размер пластины	Тип держателя	Стандартное количество пазов	Доступность кастомизации
1 дюйм / 2 дюйма	Одиночный/Многоместный	1, 5, 10, 25	Полностью настраиваемый
3 дюйма / 3.5 дюйма	Одиночный/Многоместный	1, 5, 25	Полностью настраиваемый
4 дюйма / 4.5 дюйма	Многоместный	25	Вариации ручек и шага
5 дюйм / 6 дюйм	Многоместный	25	Вариации ручек и шага
8 дюйм / 12 дюйм	Многоместный	13, 25	Высокоточная кастомизация